

Heat Sink Compound

1. Allgemeine Beschreibung

Die Paste verbessert die Wärmeleitfähigkeit und dient als effiziente Wärmeableitung bei elektronischen Bauteilen.

2. Produktmerkmale

- Hohe Wärmeleitfähigkeit.
- Ausgezeichneter Feuchtigkeitspuffer.
- Geringer Gehalt an metallischen Verunreinigungen.

3. Anwendungsbeispiele

- Leiterplatten.
- Elektrische Baugruppen.
- Steuergeräte.

4. Gebrauchsanweisung

- Auf einer sauberen, trockenen Oberfläche anwenden.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht an unter Spannung stehenden Geräten anwenden.
- **Für jedes CRC-Produkt steht ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) gemäß EG-Verordnung N° 1907/2006 Art. 31 und Ergänzungen zur Verfügung.**

5. Typische Produktdaten (ohne Treibmittel)

Aussehen	Paste.
Farbe	Weiss.
Geruch	Charakteristischer Geruch.
Dichte	2.3 g/cm ³ (@ 20°C).
Gebrauchstemperaturbereich des Wirkstoffs	-50 --> 300 °C

Anmerkungen

Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte für die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt wird stets auf dem neuesten Stand der Technik und Vorschriften gehalten und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC`



Technical Data Sheet

Heat Sink Compound

verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Version KOC-HEAT_SINK_COMPOUND-20180828
Datum 28/08/2018